

請求の範囲

- [請求項1] 以下の成分（A）を含み、水分量（粉体原料中の水分を除く。）が18質量%以上55質量%以下である、焼菓子の生地を調製する工程、および
- 前記生地を加熱する工程、
- を含み、焼菓子の生地を調製する前記工程において、前記成分（A）の配合量が、前記水分量に対して、質量比で0.01以上0.24以下である、焼菓子の製造方法。
- 成分（A）：澱粉を75質量%以上含む顆粒状物であって、
- 前記澱粉として、アミロース含量5質量%以上である澱粉の低分子化澱粉を前記顆粒状物中3質量%以上45質量%以下含み、
- 前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下であって、
- 25℃における前記顆粒状物の冷水膨潤度が5以上20以下である顆粒状物
- [請求項2] 前記成分（A）の配合量が、前記粉体原料に対して0.2質量%以上30質量%以下である、請求項1に記載の製造方法。
- [請求項3] 前記焼菓子の水分量が18質量%以上45質量%以下である、請求項1または2に記載の製造方法。
- [請求項4] 前記焼菓子が、パウンドケーキ、ロールケーキ、バームクーヘン、スポンジケーキ、パンケーキ、ワッフル、アメリカンドッグおよびウーピーパイからなる群から選択される1種である、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の製造方法。
- [請求項5] 前記成分（A）の目開き0.5mmの篩の篩下の含有量が65質量%以上100質量%以下である、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の製造方法。
- [請求項6] 前記生地が穀粉を含む、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の製造方法。

[請求項7] 以下の成分（A）を含み、水分量（粉体原料中の水分を除く。）が
1.8質量%以上5.5質量%以下である、焼菓子の生地であって、
前記成分（A）の配合量が、前記水分量に対して、質量比で0.01以上0.24以下である、焼菓子の生地。

成分（A）：澱粉を7.5質量%以上含む顆粒状物であって、
前記澱粉として、アミロース含量5質量%以上である澱粉の低分子化澱粉を前記顆粒状物中3質量%以上4.5質量%以下含み、
前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下であって、

25℃における前記顆粒状物の冷水膨潤度が5以上20以下である顆粒状物

[請求項8] 焼菓子の口どけを向上させる方法であって、
前記焼菓子の生地の水分量（粉体原料中の水分を除く。）が1.8質量%以上5.5質量%以下であり、

以下の成分（A）を前記焼菓子の生地に含有させる、前記方法。

成分（A）：澱粉を7.5質量%以上含む顆粒状物であって、
前記澱粉として、アミロース含量5質量%以上である澱粉の低分子化澱粉を前記顆粒状物中3質量%以上4.5質量%以下含み、
前記低分子化澱粉のピーク分子量が 3×10^3 以上 5×10^4 以下であって、

25℃における前記顆粒状物の冷水膨潤度が5以上20以下である顆粒状物